

Stampaggio con saldatura dall'interno

Wittmann Battenfeld adotta in esclusiva la tecnologia IMIW sviluppata dalla britannica Barkley Plastics.

28 marzo 2013 07:29

Tra le novità che Wittmann Battenfeld presenterà nel corso dei Competence Days, in programma a Kottingbrunn (Austria) il 24 e 25 aprile 2013, c'è anche la tecnologia di saldatura In-Mould Internal Welding (IMIW), sviluppata dalla britannica Barkley Plastics e commercializzata in esclusiva dal costruttore austriaco.



Si tratta di una tecnica per saldare insieme due pezzi in materiale plastico, creando un guscio che protegge dall'acqua e dall'aria circuiti elettronici o etichette RFID posti all'interno. Utile quindi per l'identificazione in radiofrequenza, utilizzata sempre più spesso in ambiti automotive, packaging, medicale ed elettronica.

L'inserimento delle etichette all'interno del manufatto offre il vantaggio di proteggerle da urti, degradazione da umidità, calore o altri agenti esterni.

La tecnica IMIW si basa sullo stampaggio simultaneo di due semigusci, inserimento dell'etichetta RFID (o altri inserti) in uno dei due pezzi, traslazione dei semistampi fino a portarli uno di fronte all'altro e successiva saldatura dall'interno, mediante iniezione dello stesso materiale sulle superfici a contatto. Tutto nell'ambito del medesimo ciclo di stampaggio.

Il processo provoca una perfetta adesione sull'intera superficie di contatto e non solo lungo la linea di giunzione. Si può così ottenere una buona sigillatura senza la formazione di un cordone di saldatura; non sono quindi necessarie operazioni di finitura per asportare il materiale in eccesso.

Nel corso dei Competence Days sarà possibile vedere il processo in azione su una pressa EcoPower 110.

© Polimerica - Riproduzione riservata